

证券代码：300179

证券简称：四方达

河南四方达超硬材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-005

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	开源证券 孟欣 财通证券 余炜超 盘京投资 乔磊 混沌投资 黄琦越 南方基金 钟贇 李金哲 华夏基金 马生华 平安基金 周金菲 诺安基金 袁文翀 宝盈基金 徐也 西部利得基金 张昌平 博时基金 何海怡 深圳富安达投资 安俊杰 大朴资产 付赫 朋元资产 郭可 敦和资管 陈俊源 玖鹏资产 边梦葳 鹏华基金 周科帆

时间	2026年5月6日下午 14:00-15:00
地点	线上会议
上市公司接待人员	董事会秘书兼财务总监 李炎臻
投资者关系活动主要内容介绍	<p>与相关人员就其关心的问题进行交流，以下为会谈纪要：</p> <p>1、请介绍下目前公司的经营情况？</p> <p>公司 2026 年第一季度营业收入 1.84 亿元，同比增长 40.20%，归母净利润 4292.89 万元，同比增长 25.66%，目前公司及子公司的各个工厂都在正常有序的推进生产中，订单交付也在如期进行，沙雅的新工厂建设也在按照计划持续推进当中，公司的生产和经营一切正常。</p> <p>2、公司目前钻针产品的最新进展？</p> <p>AI 服务器 PCB 正朝着高层数、高硬度、高厚度、高孔密度的方向升级，相关研究表明，新一代 AI 芯片将采用加工难度更高的 M8、M9 覆铜板作为 PCB 基材，在 PCD 微钻钻头方面，公司已具备直径ϕ0.2mm 至ϕ3mm 的全系列供应能力，产品在寿命、精度和光洁度方面表现良好，公司在持续关注 PCD 微钻在 PCB 板等高端制造领域的应用方向，目前正在产品验证阶段，公司目前生产的 PCD 微钻在 M8 和 M9 板子上的打孔数已达到万孔级别。</p> <p>3、请介绍下公司的散热产品情况？什么时候有小批量订单？</p> <p>金刚石是性能极佳的散热材料，核心在于其较高的热物理性能：室温热导率达 2000—2200W/（m·K），约为铜的 5 倍、铝的 10 倍，同时具备电绝缘性、热膨胀系数与硅高度匹配等独特优势。四方达生产的 CVD 金刚石散热片热导率在 2000W/（m·K）以上，主要用于 GPU 散热。目前，公司金刚石散热片已通过海外客户测试，验证进展符合预期，并进入小批量供货阶段。同时，公司正加快推进沙雅年产 2.5 万片 CVD 金刚石散热基地建设，以更好匹配客户对批量、稳定交付的需求，保障订单顺利落地。总体来看，公司已具备大尺寸 CVD 金刚石散热片的规模化供货能力，在需求增长、客户拓展与产能提升的共同推动下，散热业务有望成为公司新的成长方向。</p>

	<p>4、公司目前的扩产情况是什么样的？</p> <p>公司控股子公司河南天璇半导体科技有限责任公司计划在沙雅县投资约 4.5 亿元用于建设年产 2.5 万片 CVD 金刚石生产线及附属设施。随着 AI 芯片功耗不断上升，CVD 金刚石作为更有效的散热路径，其市场需求正稳步增长。目前，公司已具备大尺寸 CVD 金刚石散热片的规模化供货能力，产品验证进展顺利。未来，随着产能提升、效率提升和产品结构升级，公司散热业务将稳步推进。</p> <p>5、公司的日常经营及安全生产是否有异常？</p> <p>公司目前的日常经营及安全生产一切正常，无异常情况。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2026 年 5 月 6 日</p>